

Edição Número 171 de 04/09/2007

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 156, DE 29 DE AGOSTO DE 2007

OS MINISTROS DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, no uso das atribuições que lhes confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição Federal, e tendo em vista o disposto no § 6º do art. 7º do Decreto-Lei nº 288, de 28 de fevereiro de 1967, e considerando o que consta no processo MDIC nº 52000.012118/2007-69, de 26 de julho de 2007, resolvem:

Art. 1º Fica estabelecido para o produto CARTÃO DE MEMÓRIA com tecnologia SECURE DIGITAL - SD, industrializado na Zona Franca de Manaus, o seguinte Processo Produtivo Básico:

I - injeção plástica;

II - fabricação do circuito impresso rígido ou flexível, quando aplicável;

III - montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso; e

IV - montagem final do conjunto.

§ 1º Todas as etapas do Processo Produtivo Básico acima descritas deverão ser realizadas na Zona Franca de Manaus, exceto a etapa descrita no inciso II, que poderá ser realizada em outras regiões do País.

§ 2º As atividades ou operações inerentes às etapas de produção descritas nos incisos de I a III, poderão ser realizadas por terceiros, desde que obedecido o Processo Produtivo Básico.

§ 3º Fica dispensada a montagem de 5% (cinco por cento) das placas de circuito impresso, em quantidade, tomando-se por base a quantidade de placas de montagem nacional no ano calendário.

§ 4º Ficam dispensadas pelo prazo de seis meses, a contar da data de publicação desta Portaria, da montagem das placas de circuito impresso do tipo filme flexível e com tecnologia chip on board.

§ 5º Fica dispensado o cumprimento das etapas descritas nos incisos I e II, até o limite de produção anual de 1.000.000 (um milhão) de unidades.

§ 6º Seis meses após, atingido o limite de que trata o parágrafo anterior, a empresa deverá optar pelo cumprimento de uma das etapas descritas nos incisos I e II, devendo encaminhar relatório a Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA, demonstrando progresso em relação à implementação da etapa objeto de sua opção, um mês após ter atingido o limite mencionado.

§ 7 o Para o cumprimento do disposto no inciso II, o circuito impresso rígido deverá ser fabricado a partir do laminado e o circuito impresso flexível, fabricado conforme o Processo Produtivo Básico respectivo.

Art. 2 o Os circuitos integrados monolíticos ou microchips utilizados na montagem das placas deverão atender, a partir de 1 o de janeiro de 2009, ao respectivo Processo Produtivo Básico, para um percentual mínimo de 50% (cinquenta por cento) da produção no ano calendário.

Art. 3 o Sempre que fatores técnicos ou econômicos, devidamente comprovados, assim o determinarem, a realização de qualquer etapa do Processo Produtivo Básico poderá ser suspensa temporariamente ou modificada, através de Portaria conjunta dos Ministros de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e da Ciência e Tecnologia.

Art. 4 o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MIGUEL JORGE

Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

SERGIO MACHADO REZENDE

Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia